

AI チップ設計拠点フォーラム(第72回)開催案内【Web開催】

1. 日時 6月27日(金)13:30-16:00

2. 開催方法

Web フォーラム

(参加登録者には6月25日～6月27日午前中に Web フォーラム参加のためのリンクアドレスを通知いたします)

3. アジェンダ

13:30-13:35 「AI チップ設計拠点フォーラムについて」
(産総研/内山 邦男)

13:35-14:20 「AIチップ設計拠点エミュレータを活用した検証効率化及び関連最新技術」
(日本ケイデンス・デザイン・システムズ社/内山 哲夫氏)

14:20-15:05 「COOL Chips 2025 における研究開発動向」
(明治学院大学/和田 康孝先生、東京電機大学/江川 隆輔先生)

15:05-15:15 休憩

15:15-16:00 「MWC25 Barcelona 2025 における技術開発動向」
(会津大学/新田 高庸 先生)